

第 50 回 電子デバイス実装研究委員会



日時：2024 年 11 月 19 日（火）13:00～16:45

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 濱田 真行（大阪産業技術研究所）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『リードフレーム向け異種材料接合用粗化銅めっき皮膜』（40 分）

.....○吉川純二（奥野製薬工業(株)）

13:50～14:30

『金属塩生成接合法を応用した Pb フリーはんだ接合技術』（40 分）

.....○山崎浩次、井上岳斗、小山真司（群馬大学大学院 理工学府）

14:30～15:10

『赤外線画像を活用したフローはんだ付けにおける工程内不良抑制システムの開発』（40 分）

.....○川添徹也（三菱電機(株)）

15:10～15:25 休憩

司会 小幡 進（(株)東芝）

15:25～16:05

『ボール盤を用いたセラミックス基材上への金属膜形成技術の紹介』（40 分）

.....○園村浩介（(地独)大阪産業技術研究所）

16:05～16:45

『次世代合金焼結技術の紹介』（40 分）

.....○上島稔^{*1}、陳伝トウ^{*2}（^{*1}(株)ダイセル、^{*2}大阪大学）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会